

30W用	ラスター彫刻					ベクター彫刻				
	パワー	スピード	PPI	パス	深さ	パワー	スピード	PPI	パス	深さ
アルミイト処理アルミ	45	80	500	1	0.0254	10	4	1000	1	0.0254
大理石	100	55	500	1	0.0762	20	4	500	1	0.0762
アクリル樹脂(浅い)	35	80	500	1	0.0254	5	4	1000	1	0.254
アクリル樹脂(深い)	5	4	1000	1	0.254					
アクリル樹脂(切断)						75	0.4	1000	1	5.08
ラバースタンプ	100	16	500	1	0.762	60	1.6	90	1	1.016
コルク	80	60	500	1	0.254	10	4	500	1	0.254
コルク(切断)						50	1.6	100	1	1.524
木材	100	40	500	1	0.508	80	4.2	500	1	0.762
木材(切断)						50	1.3	250	1	3.175
デルリン	100	29	500	1	0.381					
デルリン(切断)						75	2.4	200	1	1.524
厚紙・マットボード	45	80	250	1	0.127	20	4	250	1	0.127
厚紙・マットボード(切断)						50	3.2	200	1	1.27
人工大理石(浅い)	100	40	500	1	0.127	50	4	1000	1	0.254
人工大理石(深い)	100	20	1000	1	0.381					
ガラス	100	20	300	1	0.0254	10	4	300	1	0.0254
メラミン(浅い)	100	40	500	1	0.381	20	4	500	1	0.254
メラミン(深い)	100	28	500	1	0.508					
皮革	28	80	500	1	0.0254	5	4	500	1	0.254
皮革(切断)						50	2	200	1	2.54
二層板(RAWMRK)	34	100	500	1	-	83	10	500	3	-

ワンポイント アドバイス

ベクター切断時、完全に切り落とすことも出来ませんが上記の設定は厚みの80%程度の切れ込みを入れるようになっています。これは切断面を状態で保つためです。加工終了後に手で切り離してください。

ベクター切断時に完全に切り落としてしまいたい時は、上記のスピード設定は5~5.5倍にし、パスを10回程度にしてください。これは、1回のパスで切断できる設定にすると切断面が溶けるなどの弊害が起こるためです。但し、切り落とす時は極力ハニカム加工テーブルして材料を浮かした状態で切断してください。これはレーザーの輻射による材料裏面の溶解・汚れを防ぐためです。

ベクター切断時にカット部分の淵が汚れますが、切り離す前に乾いたティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。また、表面が白色のタイプで汚れが落ちにくい場合は、事務用のプラスチック消しゴムで軽くこすってください。

文字の部分を残して周りをラスター加工する場合(広範囲のラスター加工)は熱収縮による材料のソリ(変形)が起こります。極力、文字部分ようにしてください。